

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年10月9日(2008.10.9)

【公表番号】特表2008-527739(P2008-527739A)

【公表日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【年通号数】公開・登録公報2008-029

【出願番号】特願2007-551251(P2007-551251)

【国際特許分類】

H 01 L 21/768 (2006.01)

H 01 L 23/522 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/90 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月22日(2008.8.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

相互接続構造を製造する方法であって、  
誘電層に相互接続部を設けるステップと、

前記相互接続部の一部が前記誘電層の上面よりも上に延出するように前記誘電層をくぼませるステップと、

前記相互接続部の前記延出した部分の上に被覆キャップを堆積するステップと、  
を含む、方法。

【請求項2】

前記被覆キャップの上に層間誘電層を堆積するステップを更に含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記層間誘電層にトレンチまたはバイアを形成して、前記トレンチまたは前記バイアの底面が前記被覆キャップの上に位置するようにするステップを更に含む、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

相互接続構造を製造する方法であって、  
誘電層に相互接続ラインを設けるステップと、

前記相互接続ラインの一部が前記誘電層の上面よりも上に延出するように、前記相互接続ラインに隣接する領域において前記誘電層をくぼませるステップと、

前記相互接続ラインの前記延出した部分の上に被覆キャップを堆積するステップと、  
前記被覆キャップの上に層間誘電層を堆積するステップと、

前記層間誘電層にバイアを形成して、前記バイアの底面が前記被覆キャップの上に位置するようにするステップと、  
を含む、方法。

【請求項5】

誘電層に配置された相互接続部を含み、前記相互接続部の一部が前記誘電層の表面よりも上に延出し、前記相互接続部の前記延出した部分が被覆キャップによって覆われている、  
相互接続構造。

